

## Presseinformation

### **Viscom setzt auf zukunftsweisende 3D-Technologie im gesamten Produktangebot**

*Hannover, November 2018* – Auf der **electronica 2018** in München stellt die **Viscom AG** erstmalig ein neues 3D-Bondinspektionssystem vor. Damit dehnt der Inspektionstechnik-Experte aus Hannover sein breites Produktportfolio im 3D-Bereich von der 3D-SPI, 3D-AOI und 3D-Röntgentechnologie auch auf die Bondprüfung aus und unterstreicht somit seine Technologieführerschaft für 3D-Inlineinspektion in der Elektronikfertigung.

Zu den Highlights auf der **electronica 2018** zählt die neueste Innovation der Viscom AG: Das neue 3D-Bondsystem Typ S6056BO mit fortschrittlichster Kameratechnologie (XM und XMplus) erfüllt die gesteigerten Anforderungen für Drahtbondinspektion im Bereich E-Mobilität, beispielsweise für Speicherbatterien, und anderer sicherheitsrelevanter Leistungselektronik.

In Vervollständigung seines einzigartig breiten Lösungsangebotes können sich die Messebesucher darüber hinaus von der sehr hohen Prüfqualität und Prüfgeschwindigkeit im Bereich 3D-AOI überzeugen. Das erfolgreiche Premium-System S3088 *ultra gold* liefert eine echte Lötstellenvermessung. Als einziges System mit acht geneigten Kameras sind exakte 3D-Messanalysen möglich, um beste FPY-Ergebnisse zu erzielen.

Ein weiteres Highlight stellt die S3088 CCI (Conformal Coating Inspection) dar. Konzipiert für die gleichzeitige SMD-Kontrolle und Schutzlackinspektion kommt das System der steigenden Nachfrage im Bereich Consumer Electronics nach. Fehlstellen, Risse, Blasen, Krater oder Verschmierungen in der Schutzlackierung der Leiterplatte werden

mittels UV-Licht zuverlässig sichtbar. Zur Prozessoptimierung kann zudem die Schichtdicke an mehreren Punkten über das 3D Spot Measurement vermessen werden.

In der SMT-Fertigung hält mit wachsendem Erfolg die 3D-Inline-Röntgeninspektion Einzug. Speziell zur Prüfung von verdeckten Lötstellen oder Blaslöchern in der Lötstelle (Voids) oder auch Materialfehlern prüft das bereits mehrfach ausgezeichnete innovative Röntgensystem X7056-II elektronische Bauteile – mit ultraschneller Handlingszeit von bis zu vier Sekunden. Die 3D-Rückrechnung der X7056-II beruht auf der planaren CT. Bei komplexen Überdeckungen, wie sie bei beidseitig bestückten Leiterplatten fast ausnahmslos auftreten, können mithilfe der herausragenden dreidimensionalen Inspektionsmöglichkeiten des Systems alle wesentlichen Merkmale auch bei Abschattung durch Bauteile oder bei Multilayer-Boards in klaren Schnittbildern deutlich sichtbar gemacht werden.

Eine universelle manuelle Röntgenprüfung verspricht das 3D-MXI-System X8011-II PCB von Viscom. Flexible Wechselmodule erlauben ein perfektes Probenhandling für die Prototypen-, Stichproben- und Kleinserienprüfung. Für das Offline-Röntgensystem kann der Viscom Quality Uplink eingesetzt werden. Mit der Verknüpfung der Prüfergebnisse von SPI, AOI, AXI und MXI sorgt die Anwendung für eine vereinfachte Klassifikation und eine effektive Prozesskontrolle.

Ein weiteres Thema ist Künstliche Intelligenz, mit dem sich Viscom aus verschiedenen Perspektiven beschäftigt: Die computergestützte Verifizierung von Fehlern beispielsweise hilft den Mitarbeitern bereits jetzt effektiv bei der Vermeidung von Pseudofehlern und steigert so die gesamte Prozessqualität. Deep Learning wird bei der Programmerstellung und Komponentenzuordnung von Viscom eine immer wichtigere Rolle spielen.

Daher werden die NPI-Komponenten (New Product Introduction) in zunehmendem Maße vollautomatisch erkennbar sein.

Unter dem Motto „Solutions for me.“ bietet Viscom maßgeschneiderte Inspektionslösungen auf höchstem Niveau mit einem umfassenden, exzellenten Service-Angebot, das mit eigenen Technikern über das weltweite Service-Netzwerk für reibungslos laufende Systeme sorgt. Viscom stellt in Halle A3, Stand Nummer 642 aus.

**Bildunterschrift:** Die Viscom AG bietet maßgeschneiderte Inspektionslösungen für die Elektronikindustrie aus einer Hand – von 3D-SPI, 3D-AOI und 3D-AXI/MXI bis hin zu 3D-Bond und CCI-Systemen.

#### **Über Viscom**

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen: <https://www.viscom.de/>